SHIELD SASE STRUCTURE

Patent Number:

JP9064582

Publication date:

1997-03-07

Inventor(s):

SAITO SUSUMU

Applicant(s)::

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Application Number: JP19950211979 19950821

Priority Number(s):

IPC Classification:

H05K9/00 : H05K7/14 : H05K7/20

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED. To make uniform the quantity of heat being generated from a device over the surface thereof by fixing an independent metal piece to a part of the surface of a shield case and projecting planar parts, in parallel with each other, from the surface of the shield case and the surface of a circuit board.

SOLUTION: A heating device 3 is mounted on a circuit board 6 and brought into contact with an independent metal piece 1 having a planar part 5 formed on the shield case plane 2. This structure prevents the temperature in a unit from increasing over an allowable limit due to the heating device 3. When the position and the number of independent metal pieces 1 are set appropriately depending on the number, the quantity of heat and the mounting position of heating device 3, the shield case plane 2 can be used commonly. Since it is not required to prepare a machining die of the shield case for every product, rationalization can be achieved.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-64582

(43)公開日 平成9年(1997)3月7日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	ΓI		技	術表示箇所
H05K	9/00			H05K	9/00	U	
	7/14		7301-4E		7/14	В	
	7/20				7/20	E	

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 3 頁)

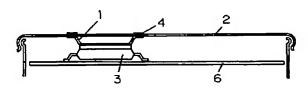
(21)出願番号	特願平7-211979	(71)出願人	000005821		
			松下電器產業株式会社		
(22)出願日	平成7年(1995)8月21日	大阪府門真市大字門真1006番地			
		(72)発明者	斉藤 造		
			大阪府門真市大字門真1006番地 松下電 産業株式会社内		
		(74)代理人	弁理士 稿本 智之 (外1名)		

(54) 【発明の名称】 シールドケース構造

(57)【要約】

【目的】 放熱兼用のシールドケース構造を提供する。 【構成】 回路基板面と平行なシールドケース2の平面 の一部に金属製の別個片を取付け、前記シールドケース 2の平面と平行で且つ、回路基板面とも平行な突起平面 部を形成し、さらに、突起平面部の周辺部に溝加工等に より自在変形部を形成した構成。

- 1 放熱用金属接触片
- 2 シールドケース平面
- 3 発熱部品
- 4 L字形突起片
- 5 平面形成部
- 6 回路基板



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 回路基板を包み込み電磁波妨害を遮蔽す る金属製シールドケースに於いて、シールドケース面の 一部に金属製の別個片を取付け、前記シールドケース面 と前記回路基板面とに平行な突起平面部を形成した事を 特徴とするシールドケース構造。

【請求項2】 別個片の突起平面部の周辺部に自在変形 部を設ける事で回路基板との平行を確保した事を特徴と する請求項1記載のシールドケース構造。

【請求項3】 別個片の一部に設けたL字状突起をシー 10 ルドケースに設けた孔に嵌合し、取付けた事を特徴とす る請求項1または請求項2記載のシールドケース構造。

【請求項4】 突起平面部をシールドケースの一部を絞 り加工等により形成したことを特徴とする請求項1また は請求項2記載のシールドケース構造。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はテレビジョン受像機のチ ューナや髙速デジタル信号処理回路ユニットの組立等に 使用するシールドケース構造に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来の代表的な電磁波シールド構造、例 えば、テレビジョン受像機の高速デジタル信号処理回路 等を構成する回路ブロックは高周波成分を扱う為、近接 する回路ブロック間の相互干渉(クロストーク)の防止 策の代表例としてはシールドケースで回路基板を覆う形 態があげられる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】その場合、回路基板上 の実装部品に比較的高い消費電力の発熱体があるとシー 30 ルドケース内に熱がこもり、高温となって実装部品の耐 熱性許容限界値を越える場合が少なくな伊。そのような 場合、使用時の性能や信頼性に支障が生じる危険性を伴 う。又、許容限界値を越す場合には放熱用ヒートシンク 等の部品費用や取付費用等コスト高となる欠点があっ た。又、ヒートシンク取付の為ユニットのシールドケー ス容積が大きくなると共に、シールドケース内の雰囲気 温度は殆んど低下しない欠点があった。

【0004】本発明は上記従来の難点を解消するもの で、発熱部品からの熱量を発熱部品表面に均一に、且つ 40 最大の面積で接触させた突起状の平面部にいち早く直接 熱伝導させてシールドケースに熱伝導させて、更にはシ ールドケース表面からシールドケース外に熱放散する事 でシールドケース内温度を比較的低く抑える効果を上げ ようとするものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】発熱部品からの熱を効率 良くシールドケースに熱伝導させる為には発熱部品との 接触面積を最大にする必要がある。

体に均一である事が熱伝導効率が高くなる。従って、平 面接触部の周辺部には自在に変形する形態とする必要が ある。

【0007】本発明の構成では、回路基板上の発熱部品 表面から発する熱量を直接伝導により効率良くシールド ケースに熱伝導させ、その事によってシールドケース内 の空気の温度上昇を最小限にする事を実現するものであ

【0008】また、発熱部品位置を限定する場合は発熱 部品と接触させる突起部を別個片とせず、シールドケー スの一部を絞り加工等により膨らませた突起部形成とし た構成特徴している。

[0009]

【作用】その結果、放熱の為のヒートシンク等が不要と なって、部品費用や取付費用の合理化が図れる一方、ユ ニットも薄型設計が可能となるものである。 又、回路 基板は商品により発熱部品位置が異なるが、発熱部品と 接触させる部分を別個片とする事で、発熱部品位置は限 定されなくなる。その結果、発熱部品位置が異なる商品 20 に対してもシールドケースは共通的に使用出来る長所も 合わせ持つ手段である。

[0010]

【実施例】以下、本発明の実施例について、図面を参照 しながら説明する。

【0011】(実施例1)本発明の一実施例におけるシ ールドケース構造の断面図1、図2は図1の要部側面図 である。図中、符号1は発熱部品と接触する平面形成部 を有する有する金属製別個片。2は回路基板と平行なシ ールドケース面。3は回路基板上に実装される発熱部 品。4は金属製別個片1に設けたシールドケースへの取 付用し字形突起形成部。5は発熱部品と接触する平面形 成部。6は回路基板。7はL字形突起形成部の嵌合用及 び放熱用に設けられたシールドケースの孔。

【0012】(実施例2)本発明の一実施例におけるシ ールドケース構造を図3、図4に示す。図3は本発明の 一実施例における発熱部品と接触させる突起形成片の平 面図、図4は本発明の一実施例における発熱部品と接触 させる突起形成片をシールドケースへ取り付けた状態の 要部断面図を示す。この場合は、発熱部品と接触させる 凸平面形成部を有する金属製別個片をシールドケースと 一体化させたもので有る。なお、回路基板と平行なシー ルドケースの平部面を絞り加工等により成型してよいと とは言うまでもない。

[0013]

[発明の効果] 本発明のシールドケース構造を回路実装 ユニツトとして用いる事により、発熱部品によりユニッ ト内温度が許容限度より上昇するのを防止する。また、 発熱部品の数と熱量と実装位置に応じ、適宜、金属製別 個片の位置や数量を設定する事で、シールドケースを共 【0006】この場合、発熱部品面との接触は接触面全 50 通的に使用出来るものである。その結果、商品毎にシー

3

ルドケースの加工型を製作する必要がなくなる等、大きな合理化が達成出来るものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例におけるシールドケース構造の断面図

- 【図2】本発明の一実施例における突起形成片の側面図
- 【図3】本発明の一実施例における突起形成片の平面図
- 【図4】本発明の一実施例における突起形成片をシール

ドケースへ取り付けた状態の要部断面図

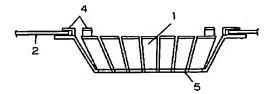
*【符号の説明】

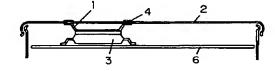
- 1 放熱用金属接触片
- 2 シールドケース平面
- 3 発熱部品
- 4 L字形突起片
- 5 平面形成部
- 6 回路基板
- 7 孔

【図1】

- 1 放熱用金属接触片
- 2 シールドケース平面
- 3 発熱部品
- 4 L字形突起片
- 5 平面形成部
- 6 同胜其据







【図3】

【図4】

